

CVD 厚膜ダイヤモンドを用いたソリッド型ロータリドレッサのドレッシング性能

北見工業大学 ○野田昌洋, 久保明彦, 田牧純一, 杉野 豪

要 旨

内面研削用ビトリファイド CBN クイルと連続的に接触するソリッド型ロータリ CVD ダイヤモンドドレッサを提案している。本報告では、低速回転型 CVD ダイヤモンドドレッサの幅を変化させてドレッシング性能に及ぼす影響を検討し、さらに従来のダイヤ埋込み式単層ドレッサおよびメタルボンドドレッサと比較した。

1. はじめに

小径内面研削などに使用される小径ビトリファイド CBN クイルの性能を引き出すためには、研削抵抗をできるだけ低くしてクイルの弾性変形を最小限に抑え、切れ味が持続するようなドレッシング技術の開発が必要である。筆者らは、その要求を実現するために CVD 厚膜ダイヤモンドディスクを用いたソリッド型ダイヤモンドロータリドレッサを提案し、その有用性を検討している。本報告では、低速回転型 CVD ダイヤモンドドレッサの幅を変化させ、ドレッシング性能に及ぼす影響を検討している。

2. ソリッド型 CVD ダイヤモンドロータリドレッサ

図 1 に示すように、ドレッサ作業面の全体が CVD ダイヤモンド厚膜で構成されたソリッド型 CVD ダイヤモンドロータリドレッサ(CVDドレッサ)を用いた。ドレッサ作業面は研削クイルと常に接触し、その軌跡はロータリドレッサとクイルの速度比 V_d/V_q の影響を受けない連続的な螺旋となる。すなわち、幾何学的には単石ダイヤドレッサの場合と同一の軌跡を実現できる。また、従来のロータリドレッサのようにクイルと断続的に接触しないため、クイルの偏心や振動を抑制することが期待できる。図 2 に CVDドレッサの外観とドレッサ作業面の顕微鏡写真を示す。

3. 実験方法および実験条件

実験装置として、オイルミスト潤滑スピンドルを搭載した回転数が 150,000 rpm の CNC 内面研削盤を使用した。ロータリドレッサの駆動装置としてベルト駆動型ドレッサを採用し、120 rpm の極低速で回転させた。ドレッシング時の速度比 V_d/V_q は -0.007 である。この装置を研削盤のテーブルに装着し、Φ4.7 mm のビトリファイド CBN140 クイルのドレッシングを行った。ドレッサには CVDドレッサの他に、比較のための単結晶ダイヤモンド粒を一定間隔で埋込んだドレッサ(SL60), SD270 メタルボンドホイールからなるドレッサ(MB270)を用いた。

また、CVDドレッサの幅は電着ダイヤモンド砥石を用いて作業面の角を削ることによって変化させ、 $D_B = 0.14, 0.2, 0.24, 0.5 \text{ mm}$ とした。いずれの場合にも、ドレスリードを一定値 ($L_d = 40 \mu\text{m}$)としたため、CBN 砥粒の同一点を通過す

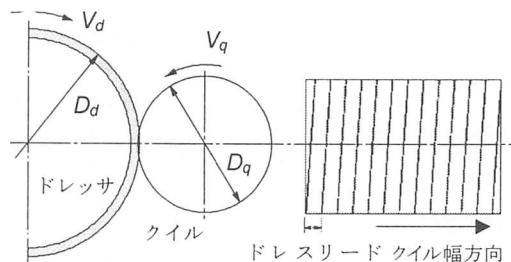
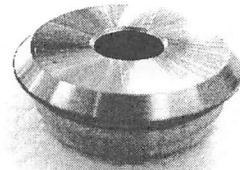


図 1 ドレッシング方法



(a) ドレッサ外観



(b) ドレッサ作業面

図 2 CVD ドレッサ

表1 実験条件

研削盤	CNC 内面研削盤(セイコー精機)
研削クイル	BZ140NM34V $D_q = 4.7 \text{ mm}$, $B = 5 \text{ mm}$ 回転数 $N_q = 150,000 \text{ rpm}$ ($V_q = 37 \text{ m/sec}$)
ドレッシング	低速ドレッシング すべりジャーナル軸受、ベルト駆動 回転数 $n_d = 120 \text{ rpm}$ 速度比 $V_d/V_q = -0.007$ (up cut) ドレッサ $D_d = 40 \text{ mm}$ ①CVD ドレッサ ドレッサ幅 $D_B = 0.14, 0.2, 0.24, 0.5 \text{ mm}$ ②ダイヤ埋込み式単層ドレッサ SL60, 1円周 60 個、ドレッサ幅 0.2 mm ③メタルボンドドレッサ MB270, ドレッサ幅 0.16 mm ドレッサ送り速度 $f_d = 6,000 \text{ mm/min}$ (ドレスリード $L_d = 40 \mu\text{m}$) ドレッサ切込み量 $A_d = 0.2 \mu\text{m}, 50 \text{ pass}$
研削	工作物回転数 $n_w = 1,500 \text{ rpm}$ 工作物 SUJ2 (Hrc58~63) プランジ速度 $f_w = 0.2 \mu\text{m/rev}$ 累積切込み量 $\Sigma A_w = 0.5 \text{ mm}$
クーラント	水溶性 W2 種 1 号(80 倍希釈)

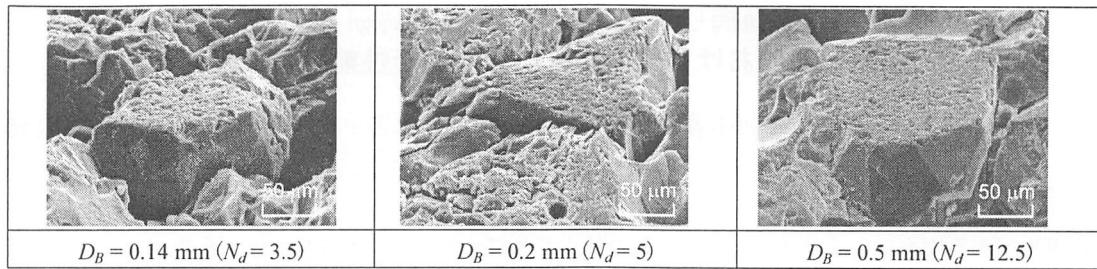


図 3 CBN 砥粒切れ刃の SEM 写真

る被ドレッシング回数 $N_d (= D_B / L_d)$ はそれぞれ、3.5, 5, 6, 12.5 回となる。ドレッシング前のクイル作業面はダイヤモンド粒埋込み型ドレッサ(1円周 90 個)を用いて、ドレッサ送り速度 $f_d=400$ mm/min, ドレッサ切込み量 $\Delta_d=1.0$ μmで数回ドレッシングを行うことにより目潰れ状態にした。ドレッシング後にSUJ2 熱処理鋼の内面プランジ研削を行い、研削抵抗、研削仕上げ面粗さ、研削クイル摩耗量を測定した。表 1 に実験条件を示す。

4. 実験結果

4. 1 CBN 砥粒切れ刃の観察

図 3 は、ドレッサ幅を変えた場合に生成させるCBN砥粒切れ刃をSEMで観察した結果である。ドレッサ幅 $D_B = 0.14$ mm の場合に注目すると、CBN砥粒切れ刃表面は全体的に平坦であるが、表層部には多少の凹凸の形成や細かく剥離したような痕跡が見られる。ドレッサ幅が増加するにつれて、切れ刃表面表層部の凹凸が小さく平坦になっており、精密ドレッシングへ移行していることが確認できる。

4. 2 研削性能

図 4 は、ドレッサ幅を変化させて、累積切込み量 $\Sigma \Delta_{\text{in}} = 0.5$ mm 後における法線研削抵抗 F_n と研削仕上げ面粗さ R_a を被ドレッシング回数 N_d に対してプロットした結果である。被ドレッシング回数の増加とともに研削抵抗および研削仕上げ面粗さは僅かであるが増加する傾向を示している。図 5 は、研削比 G (工作物除去体積/クイル摩耗体積)を被ドレッシング回数 N_d に対してプロットした結果である。被ドレッシング回数の増加とともに研削比は増加している。

4. 3 従来ドレッサとの比較

ドレッサ幅 $D_B = 0.2$ mm の場合のCVDドレッサを用いて、研削性能をダイヤ埋込み式単層ドレッサ(SL60)およびメタルボンドドレッサ(MB270)と比較した。図 6 は法線研削抵抗 F_n と研削仕上げ面粗さ R_a を各ドレッサについて比較した結果である。CVDドレッサは他のドレッサに比べて研削仕上げ面粗さは僅かに劣るが、逆に研削抵抗は低いことがわかる。図 7 は研削比を各ドレッサについて比較した結果である。研削比はメタルボンドドレッサ(MB270), ダイヤ埋込み式単層ドレッサ(SL60), CVDドレッサの順に小さくなっている。

5. まとめ

CVD ドレッサ幅が増加するにつれて、CBN 砥粒切れ刃表

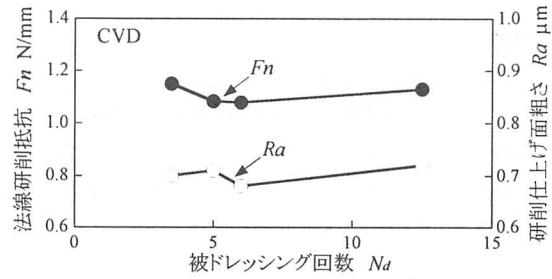


図 4 研削抵抗と研削仕上げ面粗さ

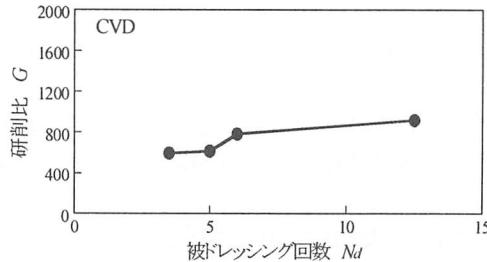


図 5 研削比

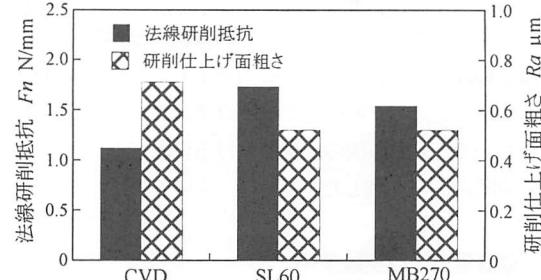


図 6 研削抵抗と研削仕上げ面粗さ

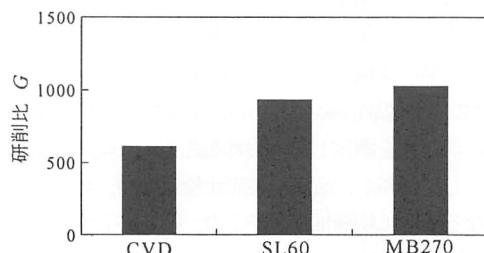


図 7 研削比

面表層部の凹凸が小さく平坦になり、精密ドレッシングへ移行した。また、これに伴い研削抵抗および研削仕上げ面粗さは僅かであるが増加する傾向を示した。